

RRAM(動作原理) ● メカニズムの有力な仮説を提案

RRAM (resistive RAM) の動作メカニズムに関する、産業技術総合研究所 磁気開発電子技術研究センター 主任研究員の澤田仁氏の講演内容を以下にまとめた。

RRAM のメモリー構造を用いた電界誘起巨大抵抗変化 (CER 效果: columnar electro-resistance) のメカニズムを検証した。その結果、RRAM の動作メカニズムの矛盾なく説明できるモデルを見いだすことができた。このモデルは、記憶電子を挿入する酸化物と金属触極の界面のエネルギー・バンドに着目して構築している。ポイントは「表面電子系」と呼ばれるグループに関する酸化物の性質と、この材料の界面での電気的強度が界面の印加により大きく変化する現象である。このモデルを検証するために実施した実験結果についても詳細に報告する。

CER効果を示すのは「表面電子系」材料

初めにCER効果を示す材料の報告例を紹介する (図 16)。まず、1994年にオランダ Royal Philips Electronics NV が説明電体である PtRuO_x の CER効果を報告した。続いて、2000 年に米 IBM Corp. が Cr を添加した SrTiO₃ と SrZrO₃ で CER効果を観察した。同じ年、米 University of Houston は PtxCu_{1-x}O の CER効果を報告している。2004年に韓国 Samsung Electronics Co., Ltd. が二元系酸化物である SmO の CER効果を実証した。

これらの材料が示す CER効果の特徴は、空置での現象であること、バイオ電圧で説明できること、抵抗値変化が不揮発性であることの 3 点である。このような特徴から、CER効果の不揮発性メモリーへの適用が検討され始めた。先

述のことを除いた、主にヘロフスカイト型酸化物の CER 效果、ヘロフスカイト系材料特に二元系酸化物の CER 效果。

出典: CER効果実証化 (CER効果) の報告された材料	報告会社 (参考文献)
PtRuO _x	オランダ Royal Philips Electronics NV, 1994
ヘトープルTiO _x , ロードルフTiO _x	米 IBM Corp., 2000, 2001
Pt-Cu-Al-O	米 University of Houston, 2000
PtSrGaCuO _x	ロシア RSCA, 2001
Pt-Cu-Al-O	シニア, 米 University of Houston, 2002
PtRu, TiO _x	米 Research Center JRC, 2003
PtCuGa ₂ Mo ₃ O ₁₀	中国 日本大学, 2004
HfO _x	韓国 Samsung Electronics Co., Ltd., 2004

図16 RRAM 材料の実証報告 (表面電子系)

RRAM のメモリー構造を用いた電界誘起巨大抵抗変化の報告があるとされており、(左)が表面電子系と呼ばれるグループに属する。ここに挙げてあるうち、PtRu が二元系酸化物で、その特徴はヘロフスカイト型酸化物を持つ特徴である。表面状態結合モデルのデータ。

図17 ●電界や電荷、電子
電子が変化
導体電子が存在するでは、
電子が電子サイトに吸収し
ている、電子や電荷、電子
はともとその電子の電子が突
然放出するようになり、電気
伝導度や電圧などの操作
値が大きく変化する。その
一因が CER効果や CEM
効果である。導体表面層
が形成されるアース。

